

## SCHEDA TECNICA A24063

Preform SolderQuik® BGA per riballare i BGA con body 31x31 mm, 524 sfere eutettiche Sn63 Pb37 diametro 0.76 mm e matrice 24x24.

Le preform SolderQuik® BGA sono costituite da una serie di sfere di saldatura incorporate in un supporto idrosolubile.

Le preform sono disponibili in quasi ogni tipo di BGA, con sfere di vari diametri.

Le preform SolderQuik® BGA permettono di posizionare con precisione una nuova serie di sfere sul BGA da riballare, basandosi su semplici proprietà fisiche piuttosto che sull'abilità dell'operatore. Le sfere sono fissate e centrate sul supporto idrosolubile con una tolleranza di 0.01 mm.

Ingredienti pericolosi	Numero C.A.S	Ingrediente % in peso	OSHA PEL	ACGIH TLV
Pb	7439-92-1	0 - 90*	0.05 mg/m <sup>3</sup>	0.15 mg/m <sup>3</sup>
Sn	7440-31-5	10 - 96.5*	2 mg/m <sup>3</sup>	2 mg/m <sup>3</sup>
Ag	7440-22-4	0 - 4	0.01 mg/m <sup>3</sup>	N.E.
Cu	7440-50-8	0 - 1	0.1 (fume)	N.E.
<b>Ingredienti non pericolosi</b>				
Carta idrodispersibile	N/A	N/A	N/A	N/A

\*La percentuale in peso di piombo e stagno varia in base al numero di sfere di saldatura sul preform e al tipo di sfera di saldatura utilizzata.

## Usare cautela durante l'apertura delle confezioni blister dei preform BGA.

1. Posizionare la confezione su una superficie piana, con il lato del coperchio rivolto verso l'alto.
2. Tenere la scatola e premere delicatamente il coperchio con un dito indice (vedere Figura 1).
3. Tenere un angolo del coperchio e sollevarlo delicatamente (vedere Figura 2) finché il coperchio non si sgancia completamente dal corpo della confezione (vedere Figura 3)

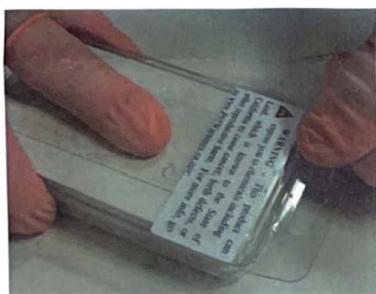


Figura 1



Figura 2



Figura 3

**I preform non utilizzati devono essere conservati in un luogo fresco, asciutto e al riparo dalla luce.**

Nota: possono verificarsi “sfere libere” a causa di una manipolazione o conservazione non corretta

## Durata di conservazione dei preform BGA SolderQuik™ – Note applicative

I prodotti SolderQuik possono essere conservati fino a due anni dalla consegna, purché le condizioni di stoccaggio siano ben controllate.

Migliaia di dispositivi grid array sono stati sottoposti con successo a reballing utilizzando preform BGA conservati fino a due anni nelle seguenti condizioni:

- Umidità relativa < 60%
- Temperatura ambiente compresa tra 60 e 80 °F
- In un ambiente buio

L'esposizione a un'elevata umidità relativa (>50%), a una temperatura ambiente >80 °F e alla presenza di alcune sostanze chimiche aerodisperse, come zolfo, ammoniaca o cloruri acidi, accelera la formazione di ossidi sulla superficie della sfera, con possibile riduzione della bagnabilità.

Il tipo di fluxante utilizzato durante il ciclo di rifusione svolge un ruolo importante. Le leghe di saldatura esposte ad atmosfere ricche di ossigeno a temperature elevate (>125 °C) si ossidano rapidamente, mentre la funzione principale di qualsiasi fluxante è proteggere la lega e il punto di interfaccia, riducendo al contempo la tensione superficiale tra di essi. I fluxanti a bassa attività (no-clean) hanno capacità ridotta o nulla di trattare ossidi già presenti, mentre quelli ad alta attività (a base di acidi organici) sono in grado di rimuoverli.

Il supporto laminato del preform è un composto di carta idrosolubile e plastica ed è soggetto ad assorbimento di umidità. Durante il ciclo di rifusione, questa umidità viene espulsa dal laminato grazie alle sue rapide caratteristiche di trasmissione e non influisce sulle prestazioni del prodotto.

La lega delle sfere di saldatura è quindi il fattore determinante nello sviluppo di un piano di stoccaggio interno.

**CEPEITALIA SRL**

*Via Michelangelo Buonarroti, 15 - 20090 Cesano Boscone MI*

*CF / P.I. IT03749070961*

*commerciale@cepeitalia.it*

*www.cepeitalia.it*